

国内EDA并购整合潮涌 助力企业打造全谱系全流程能力

证券时报记者 王一鸣

继新思科技、西门子EDA等国际巨头接连出手并购之后,国内EDA(电子设计自动化)产业的并购步伐明显提速。

4月11日晚间,国内EDA领先厂商概伦电子披露,公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,本次交易完成后,锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公司。

3月31日,行业龙头华大九天亦公布了收购芯和半导体100%股权预案;前者在3月下旬还通过九天盛世EDA基金在亚科鸿禹B轮融资中战略领投……

对于近阶段EDA频繁涌现的并购案,芯谋研究企业部总监王笑龙近日向证券时报记者分析:“并购整合是EDA产业发展的重要手段。全球EDA规模约150亿美元,容纳不下太多企业,长期以来国际三巨头也是通过多年发展以及不断并购,各自构建了完整的产业链生态链,形成非常高的壁垒。近几年国内EDA企业纷纷冒出,但以开发单点工具居多,在此背景下,行业龙头可以通过并购整合补齐多款关键核心工具,这不仅可以构建更完整的生态系统,还有助于实现全流程EDA平台企业这一目标,提升面对国际巨头的竞争力。”

他还指出,在国际贸易摩擦不断升级背景下,国内EDA企业不可避免受到一定影响,这更需要企业在技术创新、深化产业链布局方面多下苦功;同时,DeepSeek等大模型在EDA领域已展现出一定的应用潜力,国内EDA企业亦可重视在AI技术领域的投入。



图虫创意/供图

1 “芯片之母”

EDA是指利用计算机辅助设计软件,来完成芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。它涵盖了电子设计、仿真、验证、制造全过程的所有技术。

“芯片设计,好比‘在头发丝上起高楼大厦’,要在指甲盖大小的硅基板上构筑百亿晶体管迷宫。若没有EDA软件,设计师好比要上万个施工工地画施工图纸,却需要手工完成,显然是天方夜谭。”一位芯片设计师向证券时报记者比喻说。

作为产业最上游,EDA软件又被誉为“芯片之母”。机构测算,2024年,全球EDA市场规模约为157.1亿美元,预计2026年将达到183.34亿美元,

小小的EDA市场却撬动着5000亿美元的半导体产业。

在中国市场,EDA产业同样表现强劲。2023年,中国EDA市场规模约127亿元人民币,约占全球EDA市场的10%。据中国半导体行业协会预测,2025年中国EDA市场规模将达到184.9亿元。

从行业格局看,长期以来,全球EDA市场被新思科技(Synopsys)、楷登电子(Cadence)和西门子EDA(Siemens EDA)三家国际厂商(又称“EDA三巨头”)垄断,上述厂商拥有完整的、有总体优势的全流程产品。在中国市场,目前三家国际巨头占据主导地位,合计市

场份额超过70%。

经过多年发展,国内EDA厂商华大九天和概伦电子等凭借部分领域的全流程工具,或在局部领域的领先优势,位列全球EDA行业的第二梯队。第三梯队的企业主要聚焦于某些特定领域或用途的点工具,整体规模和产品完整性与前两大梯队的企业存在明显的差距。

“在过去5年,国内EDA企业数量从10家增长到了100家以上,营收过亿元的公司不足两位数,至今仍是小而散的局面;另一方面,EDA行业技术门槛高,国内企业在高端领域仍与国际巨头存在差距,迫切需要发展出一些龙头企业。在这过程中,企业自研是一方面,另一方面则在于并购和整合,这是企业拓展产品线一个非常重要的手段。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向证券时报记者表示。

2 并购潮早已涌动

回顾EDA三巨头发展史,也是从做点工具的小公司起步。这三家企业一方面持续重金投入研发,追求产品性能和效率的提升;另一方面在资本推动下,不断并购同行企业,在过去30多年里完成了约270起并购案,才成就现在的规模体量。

全球产业整合仍在继续。3月5日,英国竞争监管机构批准了新思科技以350亿美元收购安斯科技(Ansys)的交易。方案显示,此次合并将在核心EDA领域和极具潜力的新兴增长领域(如汽车、航空航天和工业智造等),进一步加强新思科技“从芯片到系统”发展战略,而Ansys在这些领域拥有成熟的业务布局 and 成功的市场经验。

去年10月31日,西门子宣布将以每股113美元的价格,收购美国工业仿真软件厂商Altair Engineering,交易总价值约106亿美元,预计将于2025年下半年完成。

在此背景下,国内EDA产业的并购步伐亦提速。3月31日,华大九天收购芯和半导体100%股权预案出炉,后者拥有对标国际巨头的从芯片到系统的仿真产品。华大九天认为,该交易将有助

公司补齐多款关键核心EDA工具,打造全谱系全流程能力。

“结合双方产品平台,可以构建更完整的产品链条和生态系统,提升整体竞争力。交易完成后,华大九天将构建从芯片到系统级的EDA解决方案,将打破EDA现有的集成电路芯片设计、制造及封装市场规模的天花板。”华大九天指出。

无独有偶,4月11日晚间,概伦电子亦宣布收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权。标的公司主要从事半导体IP(知识产权Intellectual Property)设计、授权及相关服务;概伦电子认为,参照国际EDA巨头如新思科技和楷登电子的发展路径,EDA和IP的深度协同是领先EDA企业发展的必经之路,也是推动集成电路行业的工艺演进和高端芯片竞争力提升的重要支撑。

事实上,国内EDA产业的整合并购早已涌动。

据统计,近两年国内至少已有20笔投资和收购交易涉及EDA公司。例如,2022年10月,

华大九天公告拟以1000万美元现金收购芯达芯片科技100%股权;2023年5月,概伦电子收购芯智联100%股权;同年9月,广立微收购亿瑞芯43%股权……

不过,并购之后的整合风险亦为业内所关注。参考历史案例,例如在技术整合方面,2016年Mentor(现西门子EDA)收购Solido Design Automation后,历时三年才完成工具链融合。

鸿芯微纳 CEO Charlie Huang在3月中旬的某论坛上阐述了EDA这一细分赛道的并购前景。他指出,当前EDA行业企业数量众多但市场分散,行业整合或淘汰已成必然趋势,并购并非单纯资本运作,而是需结合战略眼光与执行魄力的系统工程,尤其需警惕短期业绩压力与整合风险。

针对同业整合,Charlie Huang指出,纵向并购中常面临产品线与人员冗余问题,执行者需“铁面无私”裁撤重叠业务,否则难以实现市场协同效应;横向并购则需瞄准行业龙头,即使溢价收购也要敢于决策,但前提是股东与董事会能给予长期耐心。他还提醒,并购后的整合成效往往需5年甚至10年方能显现。

时的数据分析。

2月28日,国产FPGA芯片设计EDA软件亿灵思(eLinX)宣布接入DeepSeek,支持快速生成FPGA功能模块、精确识别代码语法和逻辑错误、提升代码性能三个主要功能。

刘伟平认为,公司有些工具已开始采用AI技术,帮助工程师实现了明显的效率提升,有些原来需要做10个小时的工作,现在1个小时就能完成。不过,他也表示,目前AI对于EDA工具的影响更多是辅助性的。在EDA行业,工程师工作的核心方法是计算,但AI的基本技术方式是推理,而推理的结果尚难实现绝对精准。



A股公司回购热情不减 超亿元大手笔频现

证券时报记者 赵黎均

上市公司增持回购热度持续。

4月15日晚间,市值超1700亿元的万华化学(600309)公告,公司拟不低于3亿元(含)且不超过5亿元(含)回购股份,具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购资金来源为上市公司自有资金,将用于注销并减少公司注册资本。

截至4月15日午后收盘,万华化学股价报56.26元/股。根据公告,本次回购股份价格为不超过99.36元/股(含)(不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。

万华化学表示,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司董事长廖增太先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于减少注册资本,优化公司资本结构,提升公司股东价值。

另外,15日晚间江铃汽车(000550)也披露,拟以自有资金,回购不低于1.5亿元(含)且不超过2亿元(含)公司股份。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购价格不超过22元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

按照本次回购金额上限2亿元,回购价格上限22元/股进行测算,回购数量约为909.09

万股,回购股份比例约占公司总股本的1%;按照本次回购金额下限1.5亿元,回购价格上限22元/股进行测算,回购数量约为681.82万股,回购比例约占公司总股本的0.8%。

江铃汽车表示,本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者合法权益,增强投资者信心,并进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力。回购股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将被注销。

此外,15日晚间TCL科技(000100)也披露,拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的股份,回购股份的总金额不低于7亿元(含)且不超过8亿元(含)。回购价格不超过6.7元/股。按回购总金额上限测算,预计可回购股份数量约1.19亿股,约占公司目前总股本的0.64%。

TCL科技也表示,本次回购是基于对公司未来发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值。回购的股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。

15日晚间,还有包括正泰电器(601877)、天虹股份(002419)、龙旗科技(603341)在内的多家A股上市公司披露回购计划,回购资金涉及规模多超过亿元。

韦尔股份去年净利增长498% 每10股派现2.2元

证券时报记者 孙宪超

韦尔股份(603501)4月15日晚间披露2024年年度报告,2024年实现营业收入257.31亿元,同比增长22.41%;净利润33.23亿元,同比增长498.11%;基本每股收益2.77元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。

韦尔股份是一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司,是全球前十大晶圆厂半导体公司之一。2024年,全球半导体行业迎来复苏,AI推动消费电子需求回暖、汽车智能化加速,行业整体进入上行周期。韦尔股份抓住市场机遇,在高端智能手机市场的产品持续导入、汽车智能化渗透加速等因素的驱动下,公司的经营业绩实现明显增长,营业收入规模创历史新高。与此同时,韦尔股份通过产品结构优化与供应链梳理增效,实现毛利率的改善和净利润的提升。

2024年韦尔股份主营业务收入为256.7亿元,较2023年增加22.43%。其中半导体设计业务产品销售收入实现216.4亿元,占主营业务收入的比例为84.3%,较上年增加20.62%;公司半导体代理销售业务实现收

入39.39亿元,占公司主营业务收入的15.34%,较上年增加32.62%。

韦尔股份年报显示,半导体设计销售业务研发投入金额约为32.45亿元,占公司半导体设计销售业务收入的15%,较上年增长10.89%。公司持续稳定地加大在各产品领域的研发投入,为产品升级及新产品的研发提供充分的保障,公司产品竞争力稳步提升。

谈及公司经营计划时,韦尔股份表示,公司将持续加大新产品开发,不断丰富半导体设计业务产品类型,进一步扩大产品的应用范围。公司将进一步深化各产品线的开发工作,同时将不断强化产品的质量管理,强化研发流程管理及产品的生产管理,以适应国际一流客户的产品需求。

韦尔股份还提及要把握并购和投资机会。公司将通过并购和投资进一步扩大公司的可触达市场,重点关注有益于公司产品组合的多样化及有益于扩大公司对邻近市场覆盖的投资并购标的。公司将继续寻求和评估潜在的目标或战略合作,以便在技术、知识产权、产品和解决方案、供应链、客户群和长期增长机会方面创造强大的协同效应。

双象股份去年净利增755% 光学材料业务爆发式增长

证券时报记者 陈澄

4月15日,双象股份(002395)披露2024年年报,期内实现营收22.9亿元,同比增长51.55%;归母净利润4.72亿元,同比大幅增长754.84%;扣非净利润达1.08亿元,同比增幅138.77%,盈利能力显著提升。

作为业绩增长的核心驱动力,公司核心业务光学级PMMA材料延续高增长态势,实现收入15.62亿元,同比增长73.09%,占营收比重提升至68.21%。在技术优势与成本管控的双轮驱动下,PMMA产品毛利率达15.36%,较上年提升2.93%。

作为国内首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业,双象股份依托重庆光学、苏州光学两大生产基地,2024年PMMA产能达15.5万吨/年。随着重庆光学年产30万吨PMMA一期项目达产,以及无锡光电材料公司的成立,公司已形成PMMA/MS完善产业链。这一战略布局不仅有望进一步推动公司业绩快速增长,更将助力打破国际巨头在该领域的长期垄断格局。

超纤业务同样表现亮眼,实现收入7.04亿元,同比增长16.93%。随着重庆超纤二期500万平米/年产能的加速推进,其在

高端人造革市场的领导地位将进一步巩固。

研发创新是推动公司高质量发展的核心动力。2024年,双象股份研发投入8147.89万元,同比增长37.99%。主要系本期全资子公司重庆光学为加强核心竞争力,进行研发所致。此外,研发团队规模同比增长17.65%,为技术迭代提供了持续的人才支撑。

在业绩大幅增长的同时,双象股份披露2024年度利润分配预案为每10股派现1.5元(含税),合计派现4023万元。公司表示,资金将优先投向重庆超纤材料二期项目建设和重庆光学材料项目。未来将根据公司的经营情况实行稳定的现金分红政策,让投资者分享收益。

展望未来,双象股份将继续聚焦光学材料与合成革双主业,加强技术研发和人才建设,全力依托重庆光学基地和超纤二期的产能释放优势,加速拓展消费电子、汽车等国内外市场,实现内销外贸并举增量,确保全年营业收入稳步增长。在国产替代的大趋势下,公司有望凭借技术积累和产能优势,进一步提升市场份额,实现业绩与估值的双重提升。

3 AI助力智能化转型

除了整合风险,在国际贸易摩擦不断升级背景下,国内EDA企业不可避免受到一定影响,这更需要企业专注技术创新、深化产业链布局。

谈及行业后续发展重点,华大九天董事长刘伟平在今年2月份曾表示,在摩尔定律面临失效时,Chiplet(又称“小芯片”技术)会是非常重要的方向之一。EDA三巨头还没有针对Chiplet的完整原生工具,现存工具都是修改补充来的,因此在原生Chiplet工具方面存在大量的机会。

同时,半导体产业正在经历由AI带来的深刻变革,EDA这一细分领域亦不例外。北京社科院研究员王鹏近日向证券时报记者分析称,DeepSeek等大模型的发展对

EDA行业的推动作用正在显现。人工智能(AI)技术可以通过机器学习算法优化芯片设计流程,提高设计效率和精度。例如,AI算法可以应用于EDA工具的仿真实验、布局布线等环节,加速设计过程并降低错误率。此外,AI技术还可以帮助EDA企业实现智能化转型,提升产品竞争力和市场份额。

对此,国内厂商正加紧布局。今年2月11日,广立微宣布其SemiMind平台接入DeepSeek,能够实现三方面功能:集成行业Know-how与海量工艺数据,构建专业领域知识库;支持用户通过低代码/无代码的方式,快速搭建定制化功能模块;智能化升级数据分析软件平台,提供个性化的推荐、自动化的流程管理以及实